

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	<div>☒特定对象调研</div> <div>☐分析师会议</div> <div>☐媒体采访</div> <div>☐业绩说明会</div> <div>☐新闻发布会</div> <div>☐路演活动</div> <div>☒现场参观</div> <div>☐其他（电话会议）</div>
参与单位名称/人员姓名	佛山市上市公司协会、华安证券股份有限公司、广东华骏私募基金管理有限公司、珠海巨石私募基金管理有限公司、海南远思私募基金管理合伙企业(有限合伙)、广东集成富达基金管理中心(有限合伙)、广东大兴华旗资产管理有限公司、佛山深联投资有限公司、菁英时代股权投资管理有限公司、湖南长心私募基金管理有限公司、珠海市聚隆私募基金管理有限公司
时间	2026年07月01日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：张国光；证券事务代表：林品旺
投资者关系活动主要内容介绍	<div>一、参观公司生产线及募投项目</div> <div>二、公司董事会秘书张国光先生介绍公司基本情况</div> <div>三、互动交流环节</div> <div>1. 公司今年业务情况介绍</div> <div>回复： 公司 2026 年一季度的营收实现明显同比提升，短期核心依靠产能利用率提升摊薄单位折旧成本，同步持续优化订单结构，对冲传统封装行业以市场化定价策略作为主要竞争方式所带来的毛利压力。公司管理层对公司的发展潜力抱有坚定信心，将本着对全体股东负责的态度稳健经营，全力提振公司未来业绩。 产能方面：公司具备覆盖 4 英寸-12 英寸晶圆全流程封测能力，截至 2025 年 12 月 31 日，公司产能达到 220 亿只/年的生产规模，产能利用率处于长期温和放量的态势，未来将依据业务发展需要进一步扩大。 产品结构方面：公司产品主要应用于消费电子、家电、电源管理、汽车电子、工控等领域，目前正重点向工业、新能源汽车领域和车规级产品的应用市场进行推广。依托“自有品牌+封测服务”双轮驱动模式，重点突破电源 IC、高端功率器件等工艺瓶颈，提升产品附加值。</div> <div>2. 并购项目进展情况</div> <div>回复： 公司已于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议并表决通过了《关于收购成都芯翼科技有限公司 60%股权的议案》。本次交易的备案、相关股权的交割、过户、工商变更等事项正在有序推进中，是否能最终顺利完成尚存在不确定性。针对本次收购的后续相关事项，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，及时履行信息披露义务。</div> <div>3. 公司未来与成都芯翼的整合管理方案</div> <div>回复： 在管理层保留方面，本次收购采用“控股不置换核心管理层”的整合模式，</div>

	<p>收购完成后蓝箭电子持有成都芯翼 60%控股权，保留原有全部核心管理团队运营权。这一安排旨在最大程度保留标的公司的研发团队、客户资源与技术积累，降低人才流失和订单断层等整合风险。</p> <p>交易完成后，成都芯翼原创始团队将继续持有约 36.81%的公司股份，利益深度绑定。公司将推动双方在产品、技术、市场等层面深度融合，充分发挥产业协同效应，逐步构建“芯片设计+半导体封装测试”相互促进的产业链格局。</p> <p>4. 公司远期有哪些规划</p> <p>回复：</p> <p>公司将紧跟半导体封装测试小型化、集成化、高端化、智能化发展方向，立足行业发展周期与技术变革趋势，紧抓新质生产力培育、数字经济与实体经济融合的时代机遇，以专注半导体封测主营业务为核心，以技术创新为驱动、市场拓展为抓手、人才建设为根基、资本运作为助力。公司聚焦高增长新兴领域与高端应用市场，构建差异化竞争优势，持续强化功率器件、宽禁带功率半导体器件、Clip bond、LQFP 及 BGA 封装工艺、车规级产品、存储芯片封装等领域的研发创新能力；加大晶圆级芯片封装、系统级封装（SIP）投入，在现有 SIP 技术基础上，进一步拓宽封测服务技术边界与产品种类，实现模拟电路、数字电路、传感器、存储芯片等多领域封测能力全覆盖，巩固并提升核心技术壁垒。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年07月01日